

Реферат

Объем: 99 с., 21 рис., 12 табл., 8 источников.

ВАРИАНТЫ 3D-ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ МНОГОКРИСТАЛЬНЫХ 3D-МОДУЛЕЙ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ УПАКОВКИ СОВРЕМЕННЫХ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ.

В дипломном проекте представлено исследование многокристалльных модулей (МКМ), решаются задачи их получения, дефектов их получения, а так же применений.

Объект исследования – МКМ.

Предмет исследования – является применение МКМ, в частности, их получение, функциональные возможности, а так же области применения.

Цель работы – конструкционные решения для многокристалльных модулей микроэлектронных устройств.

В процессе исследования был проведен анализ различных методов получения МКМ, определены материалы для создания корпусов, подложек, а также анализ схемотехнических решений.

Полученные результаты. Результатом выполнения дипломного проекта стала обработка информации по теме многокристалльных модулей, их применения, получения, выявление дешевизны таких разработок и дефектов.